

甲酸（HCOOH）无助焊剂回流焊Fluxless Reflow 中国一级代理商 苏州仁恩

产品名称	甲酸（HCOOH）无助焊剂回流焊Fluxless Reflow 中国一级代理商 苏州仁恩
公司名称	苏州仁恩机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吴中区胥口镇香山工坊9幢326室
联系电话	13372123118

产品详情

Heller设计并制造了可用于（HCOOH）无助焊剂回流焊炉。这款新烤箱的设计符合Semi S2 / S8安全标准（包括有毒气体）。

HELLER回流焊已应用于集成电路封装、IGBT、MINI LED、汽车、医疗、3C、航天、、电力等电子工业应用行业。多年来，HELLER与其客户一起合作，不断对设备进行持续改善和，已满足新的工艺要求。

1936 MK5（HCOOH）无助焊剂回流是一种Fluxless reflow设备，与主要用于最初bump reflow工艺的flux reflow相比，具备设备维护成本 (CoO) 低，环保，尺寸小，性能卓越的优点，因此正在迅速取代现有的flux reflow设备。Heller Industries 是回流焊技术的先驱拥有全球大市场占有率，基于经验证的稳定性和卓越品质，可提供解决方案，以满足客户对FOWLIP等的warpage工艺和高品质产品的需求。此外，在诸如chip on wafer或solder ball mount等的bonding reflow工艺中，

1936 MK5 无助焊剂回品由于设备维护成本低和性能优秀等优点，正在被批量生产及开发。

HELLER无助焊剂回流焊炉（甲酸回流焊炉）规格参数：

13 个热风对流加热区和4个冷却区；

内含酸性气体传输注入系统；

提供实时的酸性气体浓度和氧含量监测；

配备环境监测系统和酸性气体递减排出功能；

MK5型号	设备长度	加热区数量及长度	冷却区数量
1826	465cm(183in)	上下各8个加热区/长度260 cm (102 ”)	上面2个冷去 区及外部冷
1936	589cm(232in)	上下各10个加热区/长度360 cm(141 ”)	上面3个冷去 区及外部冷
2043	678cm(267in)	上下各13个加热区/长度430 cm(170 ”)	上面3个冷去 区及外部冷

苏州仁恩机电科技有限公司为客户提供集成全新半导体先进封装进口设备及材料和高端电子制造相关设备解决方案集成供应商。业务包括：半导体先进封装设备材料代理，电子制造进口设备代理，培训保养维修服务及配件，融资租赁等终端集成服务

公司网址：www.rineun-semicon.com